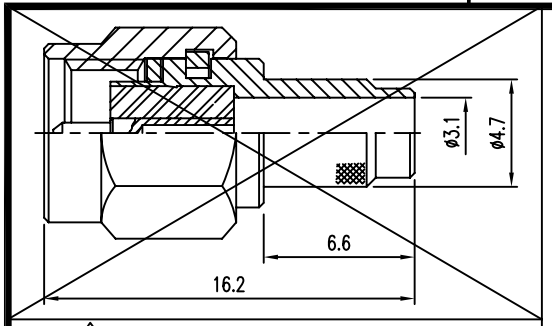


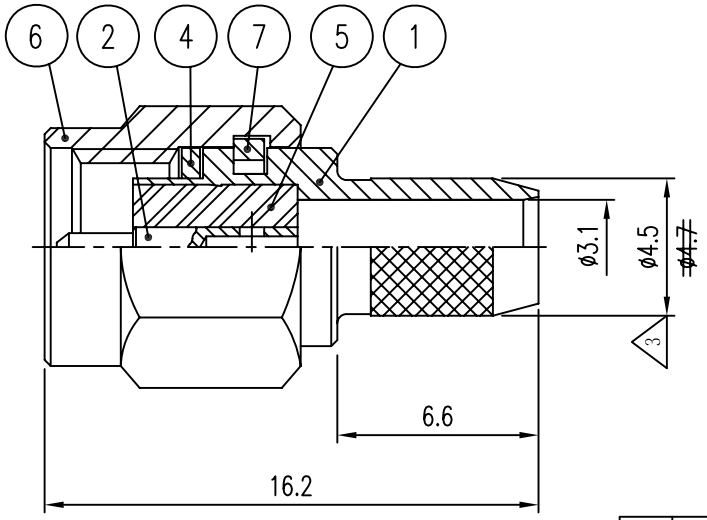
△3 REV.3 전 형상 (BODY 압착부 형상 변경)

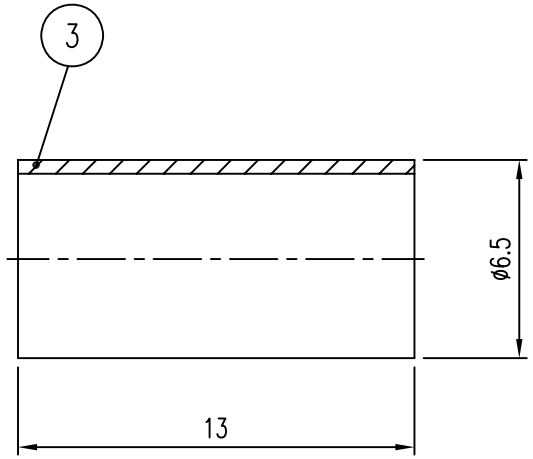
ELECTRICAL DATA

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~8.5GHz
3. VSWR (Max) : 1.2

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
IR	초도작성			1999. 06. 05.
1	[설변처리No.201201-0011] BODY 내부 뷰시비늘 추가	김인철	윤재호	2012. 02. 01.
2	[설변No.201806-0004] 조립성 개선으로 인한 공용화 치수 변경	은선영	김인철	2018. 06. 08.
3	조립성 개선으로 인한 바디 압착부 형상 변경	은선영	김인철	2020. 11. 02.
4	작업성 개선으로 인한 핀 내경 치수 변경	은선영	김인철	2020. 11. 12.
5	커넥터 압착부 바디 부러짐 현상 방지로 인한 R추가	은선영	김선호	2021. 12. 24.





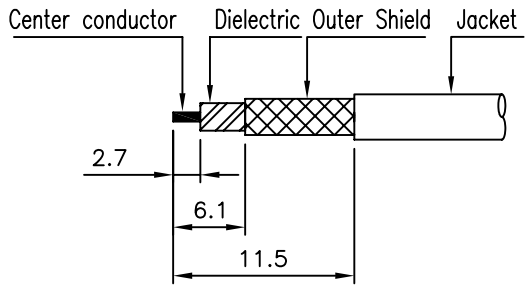
■ 작업시 주의사항

1. 핀땜 작업 시 심선 뜨지 않도록 작업할 것 (사진참조)
2. 커넥터 ASSY시 바디 끝단 케이블 자켓에 끝까지 삽입 후 압착 할 것
3. 케이블 작업 전 샘플 5본 측정 후 양산할 것

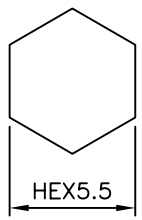
■ 측정시 주의사항

1. N(M)-SMA(M) TEST 케이블 연결 후 SMA(F)-SMA(F) 아답타 체결할 것 (PORT1, PORT2)
2. 수동 Male Cal kit 사용하여 Cal 진행 후 측정할 것

품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
7	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR00002-5/1 (R2001)
6	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00005-5/2 (K2011)
△2 5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00101-N/1 (H2069)
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1 (G2001)
3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00059-5/1 (F2027)
△4 2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00291-5/6 ~~DCT00291-5/4 (E2002)~~
△5 △3 △2 △1 1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00133-5/3 ~~DBD00133-5/4 (D2002)~~



Connector 탈피도



Crimp Tool

대체가능재질	
공통공차	.* ±0.1 .** ±0.05
재질	
열처리	
보호피막처리	

년월일	2021. 12. 24.
승인	S. H. KIM
검도	
제도	S. Y. EUN
작성부서	연 구 소
척도 NS	단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO LTD
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMA-PC-400

A4

도번 CN00918-7/1

K314-008-000